

# 独立発泡ウレタンパッド

IC1000™ VISIONPAD™

## 用途

デバイスウェーハの層間絶縁膜、メタル配線のCMP、GaN・SiCなど化合物基板研磨

## デバイスウェーハのCMPプロセスにおける業界標準品

デバイスCMPにおける業界標準のウレタンパッドです。

特殊ポリウレタン材料をベースに、高均一な微小発泡を持つユニークな構造はスラリーをうまく保持しながら、被加工物へ均等に行き渡らせ、優れた加工均一性を発揮します。高い段差緩和性能と低スクラッチ性能も実現します。

### 各種基板の高平坦化に最適

	特長
IC1000™単層パッド	・IC1000™と定盤貼付け用テープのシンプルな組合せ ・他には無い硬さと安定性で、SiC/GaNなど各種基板の高平坦化研磨に最適

### 酸化膜CMPやメタルCMPに最適

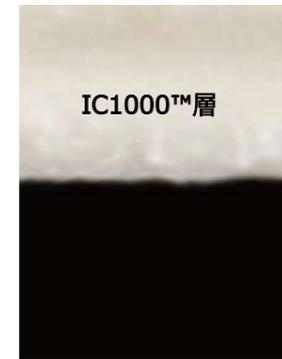
	特長
IC1000™ SUBA™積層パッド	・不織布ベースの連続発泡構造のSUBA™400をIC1000™パッドの下に積層
IC1400™積層パッド	・独立発泡構造のスポンジ状のフォームをIC1000™パッドの下に積層

### VISIONPAD™ IC1000™の次世代品

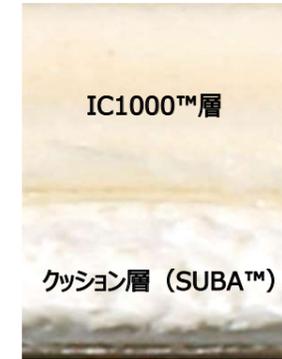
	特長
VISIONPAD™ 6000N積層パッド	・特殊樹脂の採用によりIC1000™と比べ、大幅なディフェクト性能を改善 ・パッドカットレート（摩耗速度）の35%の低減によりロングライフに期待

## 断面図比較

IC1000™単層パッド



IC1000™ SUBA™積層パッド



IC1400™積層パッド



## パッド溝加工

パッド表面に溝や穴加工を施すことでスラリーの回り込みが改善され、さらに高均一な研磨性能が発揮されます。また、2種類の表面加工を組み合わせることも可能です。



XY格子溝



同心円溝



パーフォレート



パーフォレート+XY格子溝

## パッドサイズの見方について

φ203mm～φ914mmまでの円形で、貴社研磨機の定盤径+10mm程度を目安に直径をご指定下さい。定盤貼付け用の粘着テープ付きで製作致します。

## パッド用工具

ポリッシングパッドの性能を最大限引き出すツールもご用意しています。

目立て・コンディショニングに必須  
ダイヤモンドコンディショナー  
DiaGrid® Kinik社



エア噛み・予防や貼付け精度向上に  
パッド貼付け工具



パッド交換時の労力軽減に  
研磨パッド剥がし治具



※オプションであらかじめ目立てされた状態(Break-in Free)でのご提案もご致します。